

深圳市皇庭国际企业股份有限公司 关于签署《投资合作协议》及其《补充协议》 拟投资建设特色先进功率器件封装项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、《特色先进 CLIP 工艺功率器件封装项目投资合作协议》（以下简称“《投资合作协议》”）和《特色先进 CLIP 工艺功率器件封装项目投资合作补充协议》（以下简称“《补充协议》”）为意向性约定，未对合作三方的违约责任进行约定，不具有强制性约束力，仅作为指导性文件和签订其他相关具体合同的依据，敬请广大投资者注意投资风险。

2、《投资合作协议》和《补充协议》在三方签字并加盖公章之日起生效，后续具体合作事项、实施进度和协议的执行情况尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

3、特色先进 CLIP 工艺功率器件封装项目尚需在合作方投资款项到位后才在项目所在地开展实施，如合作方投资款未能到位，合作项目存在无法执行的风险，后续公司将与合作方继续推进项目涉及的后续合作事项的落实和明确，待具体合作事宜明确并另行签署正式协议后，公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定，履行董事会或股东大会相应决策程序，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

4、本次签署的协议仅为开展合作的意向性约定，预计不会对公司 2023 年度经营业绩产生重大影响，对未来年度经营业绩的影响需视项目的实施投产情况而定。本次签署的协议不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、合同签署情况

（一）签署协议的基本情况

为积极稳妥推进公司功率半导体业务实现 IDM 模式，公司和控股子公司德兴市意发功率半导体有限公司（以下简称“意发功率”）与安徽巢湖经济开发区管理委员会签署了《投资合作协议》和《补充协议》，三方经过充分协商，在平等互利的基础上，就公司和意发功率在安徽巢湖经济开发区（以下简称“安巢经开区”）投资建设特色先进 CLIP 工艺功率器件封装项目（以下简称“项目”）相关事项达成一致。

（二）审批情况

《投资合作协议》和《补充协议》属于意向性的约定，具体实施内容和进度尚存在不确定性。根据《公司章程》等相关规定，签订程序无需提交公司董事会和股东大会审议。公司将在具体合作事宜明确后，按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的有关规定和要求，履行相应的决策、审批程序及信息披露义务。

二、协议合作方基本信息

- 1、名称：安徽巢湖经济开发区管理委员会
- 2、负责人：耿延强
- 3、统一社会信用代码：11340100MB0123131E
- 4、登记机关：安徽省人民政府
- 5、地址：安徽省合肥市巢湖半汤路传媒中心大楼
- 6、上述合作方与公司及公司的控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系，不存在直接或间接持有公司股份的情况。
- 7、类似交易情况：最近三年公司与安徽巢湖经济开发区管理委员会未发生类似交易情况。

三、《投资合作协议》和《补充协议》的主要内容

（一）《投资合作协议》

甲方：安徽巢湖经济开发区管理委员会

乙方：深圳市皇庭国际企业股份有限公司

丙方：德兴市意发功率半导体有限公司

1、项目概况

1.1 项目名称：特色先进 CLIP 工艺功率器件封装项目。

1.2 项目投资额：总投资约 5 亿元，其中固定资产投资约 3 亿元。

1.3 项目内容：由乙、丙双方进行投资，主要建设功率器件封装测试生产线，并从事相关研发、生产及销售等工作。

1.4 经济指标：项目达产后预计年度可实现营收约 12 亿元，税收约 0.9 亿元。

1.5 项目公司：乙、丙双方在安徽巢湖经济开发区注册成立项目公司，注册资本不低于 1 亿元，在甲方或其指定方股权投资相关资金到位后 1 个月内一次性实缴。项目公司在安巢经开区实际经营年限不低于 15 年，不得在协议期内通过控股权变更等方式进行义务的规避和利益的实际转让，项目公司进行控股权变更时，必须与相关关联方明确权利义务的转移和接续事宜并取得甲方的同意。

1.6 项目公司租用安巢经开区约 10000 平方米厂房作为项目运营场所，具体面积以房屋租赁合同约定为准。以后根据项目发展需要，结合园区亩均（单位面积）效益评价工作项目公司评价结果，甲方视情为项目公司调整生产经营场所。

1.7 项目建设内容应符合合肥市及安巢经开区相关环保要求，签订投资协议后，甲方积极协助乙、丙双方项目办理环评等相关审批。项目公司产品能耗、电耗、水耗需达到国家、省、市行业能耗准入标准（没有准入标准的，执行限额标准或地方能效指南）。

2、权利和义务

2.1 甲方权利和义务

2.1.1 甲方承诺在商务审批、用房申请、环评、消防、能评、融资和其它政府审批事项方面给予项目公司最大支持。

2.1.2 甲方指定专人服务项目公司，提供“一站式”服务，定期、主动联系乙、丙双方，及时协调解决项目公司入区过程中存在的问题，提供优质服务。

2.2 乙方及丙方权利和义务

2.2.1 乙方、丙方及项目公司有义务按照本协议约定,争取项目“早落地、早投产”。

2.2.2 乙方、丙方指定专人为项目负责人,及时、主动与甲方联系,通报项目进度及投资资金到位情况等,并及时提出需要协调解决的问题。

2.2.3 乙方、丙方按照安巢经开区相关要求要求进行用房装修,项目最终装修平面布局以安巢经开区相关审批为准。

2.2.4 在项目公司成立后 30 个工作日内与房屋运营管理公司办理后续手续,及时装修入驻,否则视为乙方、丙方及项目公司实质性违约,甲方可单方解除合同并另行安排项目。

2.2.5 若项目公司连续 4 年未达到补充协议约定的营收、税收等相关指标,在甲方或安巢经开区管委会相关部门启动低效用房处置程序时,乙方、丙方及项目公司须无条件配合做好退房工作。

3、争议解决

各方应真诚合作,定期沟通协商解决合作发展过程中出现的问题和争议,确因争议较大不能协商解决的,任何一方均可请求将争议提交甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

4、协议生效及其他

4.1 本协议在三方签字并加盖公章后自动生效,对三方具有法律约束力。

4.2 本协议及补充协议中约定的政策享受主体为项目公司。

4.3 本协议一式陆份,甲、乙、丙三方各执贰份,具有同等法律效力。

(二) 《补充协议》核心条款

甲方:安徽巢湖经济开发区管理委员会

乙方:深圳市皇庭国际企业股份有限公司

丙方:德兴市意发功率半导体有限公司

1、本项目总投资 5 亿元,分两期实施,其中一期投资 3 亿元(其中设备投资约 2 亿元)。通过甲方参股基金,给予项目 1 亿元资金作为股权投资支持,且该项资金须

投资在安巢经开区，具体以基金管理方与乙、丙方签订的投资协议内容为准。同时乙、丙方也须配套不低于 1 亿元资金投资在安巢经开区。

2、根据安巢经开区建设国内一流产业园区若干政策措施相关条款，基于双向约束原则，甲方将对乙方、丙方项目提供房租补贴、设备投资奖励、项目装修补贴、高层次人才奖励、高成长奖励和贷款贴息等方面的支持政策。

3、如乙方、丙方所投资项目发生变更和调整，则需按照甲方要求，与甲方重新签订项目投资合作协议和项目投资合作补充协议。

4、如遇国家和地方政策调整，则应按新政策执行。

5、本补充协议作为投资合作协议的补充说明，与投资合作协议具有同等的效力，本补充协议未涉及部分，仍按照投资合作协议约定履行，若投资合作协议失效，则本补充协议自动失效。

6、本补充协议自甲、乙、丙三方签字并盖章之日起生效；协议一式陆份，甲、乙、丙方各执贰份，具有同等法律效力。

四、对公司的影响

本次签署《投资合作协议》和《补充协议》是公司战略转型规划的重要一环，项目投产运营后，公司将实现涵盖功率半导体器件设计、晶圆制造、先进封装为一体的 IDM 业务模式。投资建设特色先进 CLIP 工艺功率器件封装项目，是公司立足意发功率现有的技术、人才优势等资源，并结合集成电路产业发展趋势，经过慎重考虑所做出的决定，旨在扩大公司半导体产业经营规模，提升公司未来核心竞争力和经济效益，对推进和落实公司战略转型规划具有积极意义。

本次项目投资建设的资金全部来源于公司和意发功率自有或自筹资金以及合作方投入的投资资金，预计不会对公司 2023 年度财务状况和经营成果产生重大影响，但若项目成功落地实施并投产运营，从长远来看，对公司业务布局和经营业绩具有积极影响。

五、风险提示

本次签订的协议仅为三方基于合作意愿而达成的意向协议，项目具体实施内容和进度将在后续签订的具体合同中予以确定；同时，本次项目分二期实施，在实施过程

中可能面临较长的投资回收期、宏观经济环境变化、行业发展趋势变化、市场风险、资金风险、技术风险、国家或地方政策调整等诸多不确定性因素影响，导致投资项目发生顺延、变更、中止或终止，或者未能达到预期收益。敬请广大投资者注意投资风险。

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对该合作相关事宜的进展情况进行及时的披露。

六、其他相关说明

1、截至本公告披露日，公司最近三年披露的框架性协议或意向性协议情况

(1) 公司与元禾（广州）半导体科技有限公司（以下简称“元禾半导体”或“标的公司”）签署《投资协议》，华夏芯（北京）通用处理器技术有限公司（以下简称“华夏芯”）作为组建标的公司的核心股东，引入皇庭国际作为标的公司的投资者。皇庭国际以投前 5 亿人民币的估值向标的公司投资 5000 万元人民币，持有标的公司股权 9.09%；因华夏芯于 2022 年 4 月退出元禾半导体，元禾半导体实控人发生变更，导致未满足《投资协议》约定的前提条件，公司暂停对元禾半导体的后续增资，目前公司仍在与对方协商沟通中。

(2) 公司与北京金拓资本投资有限公司签署《战略合作框架协议》、与深圳市合创资本管理有限公司签署《战略合作协议》，北京金拓资本投资有限公司和深圳市合创资本管理有限公司发挥其专业投资经验和利用项目资源，为公司积极寻找和推荐符合公司战略发展规划的项目，对接产业资源，为公司在半导体领域的投资提供行业分析和专业建议，就具体投资项目公司及/或其关联企业作为单一 LP，乙方作为 GP，设立有限合伙公司作为投资主体；公司与北京金拓资本投资有限公司合作金额不超过人民币 30,000 万元，公司与深圳市合创资本管理有限公司合作金额原则上不低于 20,000 万元；前述协议正在履行中。

(3) 公司与连云港丰翰益港物业管理有限公司（以下简称“丰翰益港”）签订《合作框架协议》，公司拟与丰翰益港成立有限合伙企业，由丰翰益港控股，收购方案拟采取先由合伙企业负责清偿深圳融发投资有限公司债务成为深圳融发投资有限公司主

要债权人，再由合伙企业以债权置换股权的形式收购深圳融发投资有限公司；该事项尚在共同协商推进中。

2、本次意向协议签署之日的前三个月内，公司第一大股东、持股 5%以上股东、董监高持股变动情况

股 东	身 份	变 动 方 式	变 动 前 持 股 数 量 (万 股)	变 动 数 量 (万 股)	变 动 后 持 股 数 量 (万 股)
深圳市丰盛德投资有限公司	原第一大股东一致行动人	集中竞价交易减持	1,172.00	-1,172.00	0.00
深圳市耀欣投资有限公司	原第一大股东一致行动人	集中竞价交易减持	2,093.00	-2,093.00	0.00
深圳市皇庭投资管理 有限公司	原第一大股东	司法拍卖 过户	24,216.59	8,698.59	15,518.18

3、截至本公告披露之日，公司未收到第一大股东、其他持股 5%以上股东、董监高减持公司股份的计划。若未来相关人员拟实施股份减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

七、备查文件

《投资合作协议》和《补充协议》。

特此公告。

深圳市皇庭国际企业股份有限公司

董 事 会

2023 年 1 月 18 日